AP720
自 动 编 程 系 统

每小时最高产量可达2400颗的第三代四吸嘴自动芯片编程系统

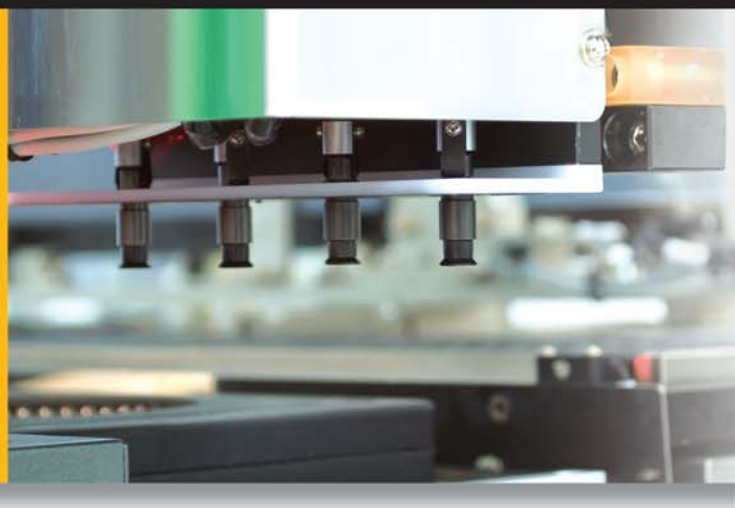
四支吸嘴

产品特征

- 每支吸嘴独立调整的流量,真空以及吸取设计确保能可靠处理极小和超薄封装芯片
- 新型的螺杆和伺服马达提升了机台运行的速度
- 配备的四个外围I/O接口以对应四支吸嘴的吸取提升了编程系统的产量
- 可支持多种包装(盘装，管装，带装)芯片的一站式操作
- 新型的Socket压合设计,减少了对Socket的损坏,以延长Socket的使用寿命
- 新一代9800编程模块搭配N型编程板,每次可同时编程四颗Nand Flash
- 机台自组排列的“快速教导”机制,可以确保最少的人为介入
- 搭配4台H9800编程器

SYSTEM GENERAL

System General,
四支吸嘴架构的先行者



我们持续追求更好的自动编程系统源于一个简单的问题：为什么一个自动机构在一个循环内不能取放多个芯片呢？ 从那以后,多年来的开发历程结合原有的业内经验,近期终获突破---全新一代AP720诞生!!!

为适应市场需求,半导体工业的封装形式不断向小/薄方向发展.

System General自动编程系统也在保持机构和吸嘴的持续创新设计. 在AP720上,每个吸嘴有自己独立的气流/真空控制和吸取的调整. 这套机构可同时,稳定的完成对4颗芯片的快速教导

The AP720 – 进一步的创新

- **新型的Socket压合驱动器** Socket对称和缓的压合,有助于延长Socket的使用寿命

- **运行机构的悬挂式设计** 节省了更多的机台空间,最多可以装配7组进出料机构

- **可选配的 " 芯片定位器"** 对吸取的四颗芯片同时做校正; 当选用一次编程4颗芯片的编程板时,可以减少用CCD校正芯片的时间.

- **新型螺杆和伺服马达设计** 与前一代机型相比较, 新型机构的棘轮速度可提升30%

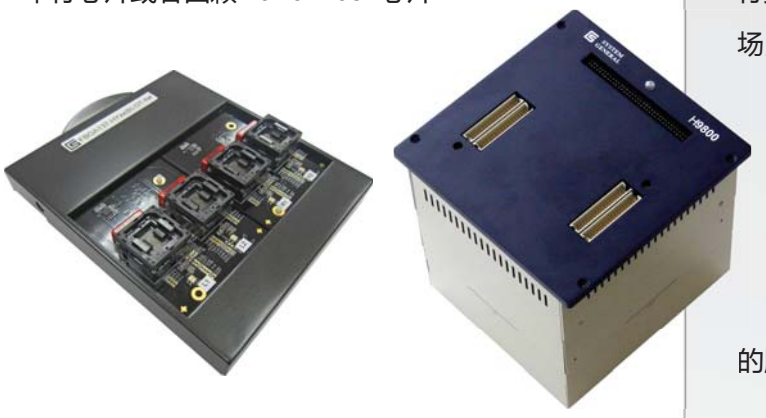
四吸嘴搭配同步的外设可达最佳产量输出

为了配合四吸嘴自动编程机构的同步性,AP720更新了软件操作接口,支持四个外设接口. AP720为达到最大的产量输出,在连接平台上,可以安装四组卷盘送料器. 同样四组管装的送料器和四组管装的出料器也可以安装.

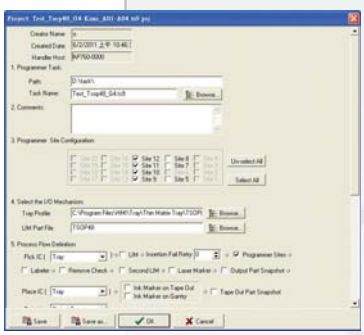
自动编程作业的核心—产品技术支持

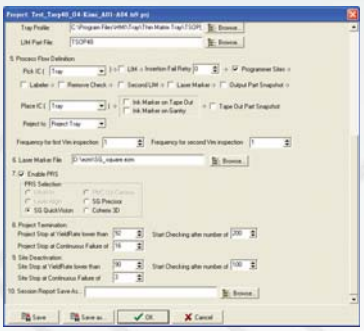
通过一定的技术培训,AP720故障可以做现场排除. 当编程遇到异常时,为了减少停机时间,我们鼓励客户自行排除和修理自动编程系统. 为了达到这点,我们的现场服务人员在机台安装时可提供深层次的培训课程和详细的机台文档.不论什么时候发生问题,一份带有图片的"标准作业流程"会一步一步指导你排除异常,以节约你的停机时间. 若确实需要至现场服务的, System General在台湾/美国/中国和全球其他地区经销网络拥用原厂服务能力的服务人员将会竭诚为你服务.

- **最新的H9800编程模块和N型编程板** 配合N型编程板的缓存设计; H9800编程模块一次可同时编程四颗串行芯片或者四颗Nand Flash芯片



- **已被实践检验过的任务和工程软件** 随着现代工业标准要求确保从最初的第一颗编程芯片到最后量产芯片编程的一致性. 我们所建立的任务和工程文件可以很容易的通过电子档案传送到你其他的编程分支机构.





AP720装配了H9800通用型编程器,它能编程Memory, MCU,PLD等芯片.
另外,AP720包含了永久免费的芯片驱动升级服务,它可为你节省大量的编程运营成本. 由于我们的客户包括了世界顶级的编程中心,著名的EMS厂商.芯片驱动库中已经支持了大量的芯片驱动供你选用.

Specifications

• 取放系统 •

- 小时产量：1400(托盘进→托盘出, 芯片定位器)
  2400(管装进→管装出,G4编程板, 芯片定位器)
- 放置精度：±0.05毫米
- 放置重现度：±0.03毫米
- 放置力度：95克
- 取放方式：四支真空吸嘴
- 芯片侦测：真空感应器

• 机构规格 •

- 尺寸：155(长)x120(宽)x165(高) 厘米,
(包括显示器) 61(长)x47.2(宽)x65(高) 英寸
- 包装后尺寸：197(长)x165(宽)x205(高) 厘米,
(没有选配件) 77.6(长)x65(宽)x80.7(高)英寸
- 净重量：930公斤(422.7磅)
- 包装后重量：1125公斤(511.4磅)

• 定位系统 •

- X-Y轴驱动系统：伺服马达驱动
- X轴精度：0.003毫米
- Y轴精度：0.003毫米
- X-Y轴重现度：0.03毫米
- X轴最大速率：1600毫米/秒
- Y轴最大速率：1600毫米/秒
- Z轴驱动系统：伺服马达驱动
- Z轴精度：0.001毫米
- Z轴重现度：0.030毫米
- Z轴最大速率：300毫米/秒

• 校准系统 •

- CCD FOV：35毫米*35毫米
- 芯片定位器：30毫米*30毫米*4

• 编程系统 •

- 编程模块：4个模块
- 编程socket：每个模块1个 或2个 或4个
- 支持的芯片种类：EPROM，EEPROM，Flash, Microcontroller,
  PLD, CPLD, FPGA,MCU及其它
- 支持封装种类：
  PLCC,TSOP,TSSOP,TQFP,PQFP,SOIC,SSOP,uBGA,CSP及其它
- H9800 RAM缓冲器：标准配置为16G-bits
- 传输方式：USB 2.0

• 系统软件 •

- 用户接口：基于Window系统的HMI
- 操作系统：Windows XP

• 操作环境要求 •

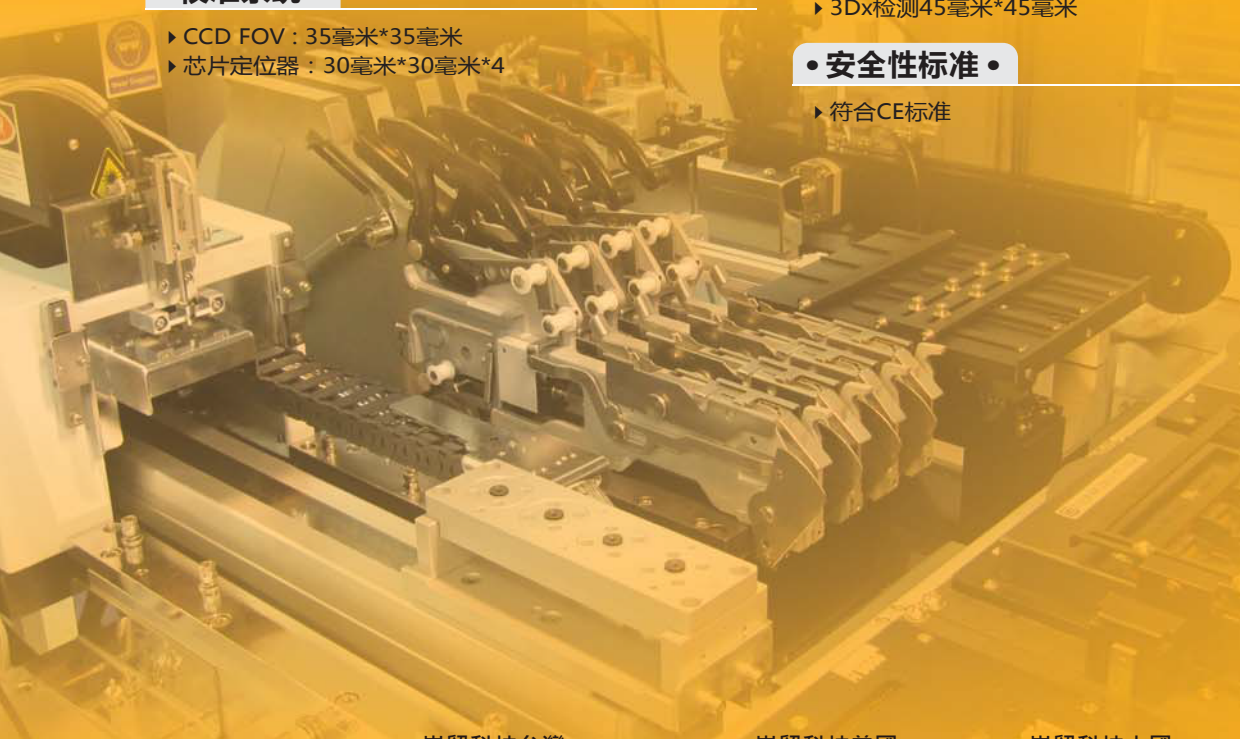
- 输入电压：220VAC，单相，3线
- 输入行频：50/60Hz
- 功耗：2.5KVA
- 气压：75~95PSI (0.4Mps~0.6Mpa)
- 气流：160liters/min(Peak)
- 操作温度范围：15~30℃（59~86℉）
- 相对湿度：35%-90%

• 选配系统 •

- 卷带装进/出8毫米~56毫米
- 管装进/出SOIC8~PLCC84
- 托盘 进/出JEDEC托盘最多20盘
- 标签送料器Hover Davis
- 激光打标机CO2(10W)
- 3Dx检测45毫米*45毫米

• 安全性标准 •

- 符合CE标准



SYSTEM GENERAL

崇貿科技台灣
新北市新店區北新路三段205-3號6樓
(TEL): +886-2-8913-1997
(FAX): +886-2-2911-1283
(URL) www.sg.com.tw
(E-Mail) info@sg.com.tw

崇貿科技美國
6469 Almaden Expy Ste 80#377
San Jose, CA 95035 USA
(TEL): +1-833-845-3900
(FAX): +1-408-263-6910
(URL) www.sg.com.tw
(E-Mail) Jonathan.lee@sg.com.tw

崇貿科技中國
深圳市南山區麻嶺工業村中鋼大廈7棟西3樓
(TEL): +86-13510816270
(URL) www.sg.com.tw
(E-Mail) xiaodan.zhang@sg.com.tw